

Singulation System

Model FMS3040



Ring offload type

Singulation system for cutting various packages

用于切割各种塑封产品的切割设备

产品信息



中文

- 多功能的offload产品处理方法
- 可对应基板尺寸为100×300mm
- 能够实现1.0×1.0mm的最小切割尺寸
- 通过高速处理实现了UPH40,000



Bulk type



Tray type

SPECIFICATION

Items		Unit	Description					
机型		—	FMS3040					
设备区分		—	Bulk type		Tray type		Ring offload type	
框架・基板尺寸	长度	mm	150—300					
	宽度	mm	40—100					
	厚度	mm	0.5—2.0					
产品尺寸	最小	mm	1×1					
	最大	mm	25×25					
基板翘曲量		—	3mm／300mm (Max.)					
切割引擎		—	Twin spindles, Twin tables					
外形尺寸	机类型	module	Cut Engine	Offload	Cut Engine	Offload	Cut Engine	Offload
	宽度	mm	1,960	325	1,960	1,500	1,960	2,290
	纵深	mm	1,760	720	1,760	1,760	1,760	1,760
	高度	mm	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,070
重量		ton	3.1		4.9		5.4	
框架・基板供给部	类型	—	Slit magazine					
	数量	pcs	4 (Max.) 当弹匣宽度为115毫米时					
产品收纳机构	类型	—	Bulk box		JEDEC Tray		12" ring magazine	
	数量	pcs	—		50 (Max.)		1—2	
吸嘴数量		—	—		2units×7pcs or 2units×11pcs			
品种转换件更换时间		min	10					
产品传送方式		—	Vacuum					
产品处理能力		UPH	40,000 (Max.)				30,000 (Max.)	

- ・ 以上数据为本公司标准机型时的规格
- ・ 以上规格根据实际需要有改良变更的可能
- ・ 如有其他特殊规格要求，另行协商



东和半导体设备（上海）有限公司
中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters

TOWA Corporation

China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
TOWA Taiwan Co., Ltd.

Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

Malaysia

TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

Philippines

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

Germany

TOWA Europe GmbH

Netherlands

TOWA Europe B.V.

the United States

TOWA USA Corporation

20250401-005-HQ